

IONENIMPLANTATION MIT FOTOLACKMASKEN

Neben dem Materialabtrag via Ätzen, dem Aufbau über das Lift-off Verfahren oder die galvanische Abscheidung kann eine Mikrostrukturierung auch über die lokale Modifizierung der elektrischen Eigenschaften des Substrates bzw. darauf abgeschiedener Schichten erfolgen. Ein gängiges Verfahren hierfür ist die Ionenimplantation, bei der bestimmte Elemente gezielt in ein Material eingebaut werden wie es im folgenden Kapitel beschrieben wird.

Grundlagen der Ionenimplantation

Prinzip

Halbleiter wie Silicium ändern ihre elektronischen Eigenschaften grundlegend, wenn Dotierstoffe wie Phosphor oder Bor in bereits sehr geringer Konzentration im ppm-Bereich in den Kristall eingebaut werden. Eine solche gezielte „Verunreinigung“ mit Elementen erfolgt üblicherweise bereits während der Kristallzucht der betreffenden Substrate mit dem Ziel einer räumlich möglichst homogenen Definition der elektrischen Leitfähigkeit.

Für elektronische Bauteile wie Dioden oder Transistoren ist es jedoch notwendig, die Leitfähigkeit bzw. den Leitungstyp (*p*- oder *n*-typ) auf μm - oder nm -Skala räumlich zu modifizieren und zu definieren. Hierzu werden bei der Ionenimplantation ionisierte und in einem elektrischen Feld beschleunigte Dotierstoffe in den Halbleiter eingeschossen.

Beschleunigungsspannung und Ionengeschwindigkeiten

Ein *n*-fach ionisiertes Atom der Masse *M* besitzt nach Durchlauf einer Spannungsdifferenz *U* (Beschleunigungsspannung) die Geschwindigkeit *v* gemäß

$$v = \sqrt{\frac{2 n \cdot U \cdot e}{M}}$$

was für ein einfach ionisiertes vergleichsweise schweres Atom wie Arsen nach einer für die Ionenimplantation vergleichsweise geringen Beschleunigungsspannung von 10 keV eine Geschwindigkeit von ca. 160 km/s, und für ein mit 500 keV beschleunigtes leichtes Bor⁺-Ion mit ca. 3000 km/s ca. 1 % der Lichtgeschwindigkeit bedeutet, wofür die obige klassische Betrachtung gewöhnlich immer noch in sehr guter Näherung genügt.

Streuprozesse zwischen Ionen und Festkörper

Im Substrat werden die Ionen durch zahlreiche, aufeinander folgende Stöße, also elektromagnetische Wechselwirkungen, mit den Elektronen und Atomkernen des Festkörpers, abgebremst.

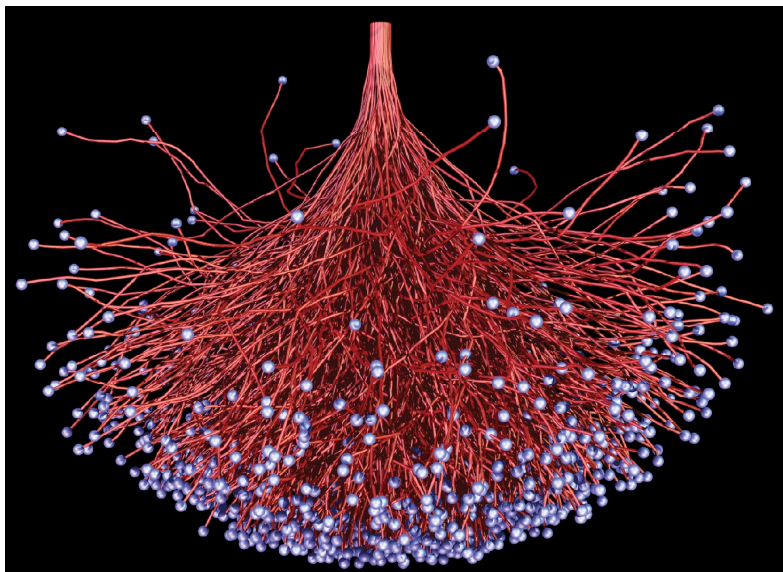


Abb. 124: Die numerisch modellierten zurückgelegten Pfade (rot) von 1000 in einem fiktiven Festkörper abgebremsten, oben mittig mit einer ursprünglich „nach unten“ gerichteten Flugrichtung eingeschossenen Ionen. Die blauen Kugeln markieren die Stellen, an denen die Ionen zur Ruhe kommen und im Festkörper eingebaut werden.

Inelastische Stöße mit Elektronen führen zur Anregung oder Ionisation der Atome der Wirtsmatrix. Bei für diese Prozesse zu geringen Ionenenergien von einigen 10 eV, also ca. 1 Promille der ursprünglichen Energie, kann ein Ladungsaustausch zwischen Ion und Festkörper im Rahmen der kurzzeitigen Bildung von „Quasimolekülen“ der Ions mit den Atomen der Matrix erfolgen.

Mit den Nukleonen des Festkörpers erfolgen in erster Linie elastische Stöße mit einem Streuquerschnitt der mit abnehmender Ionengeschwindigkeit ansteigt. Daneben können auch inelastische Stöße erfolgen, bei denen die Atome der Wirtsmatrix im Gefüge des Festkörpers versetzt werden was in kristallinen Medien für gewöhnlich unerwünschte Punktdefekte erzeugt.

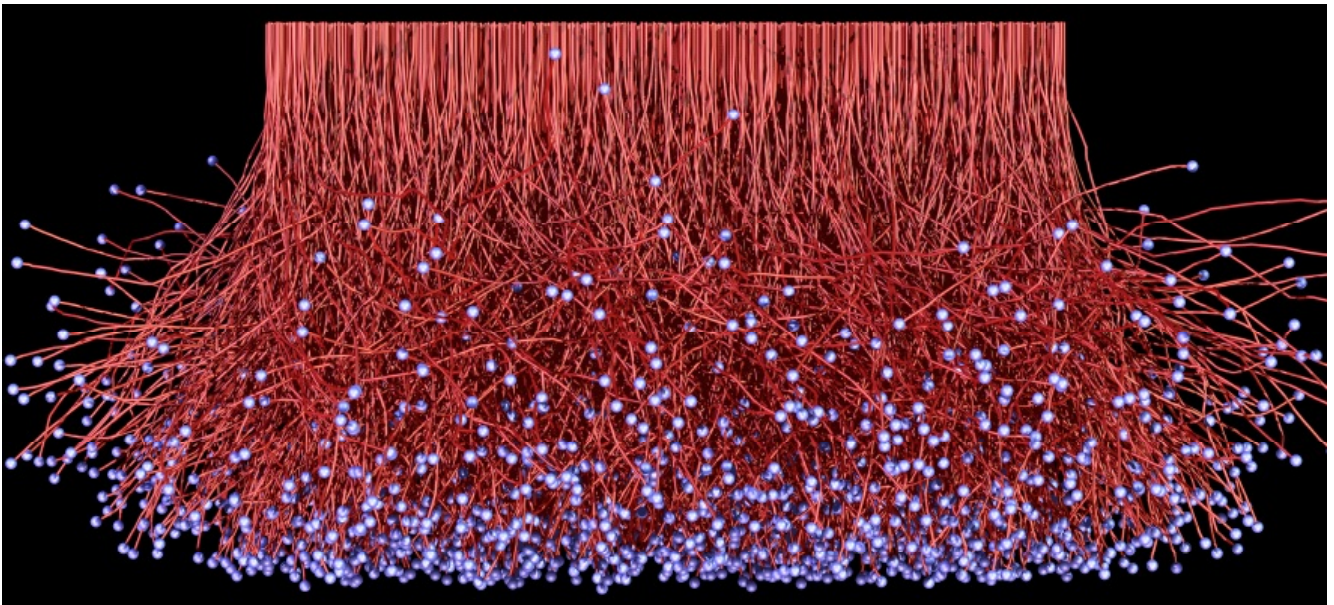


Abb. 125: Die numerisch modellierten zurückgelegten Pfade (rot) von 5000 in einem fiktiven Festkörper abgebremsten, über eine größere Fläche „von oben“ eingeschossenen Ionen. Hierbei überlagern sich die in Abb. 124 gezeigten Streukegel zu einem in die Tiefe relativ scharf begrenzten Konzentrationsprofil der implantierten Ionen (blaue Kugeln).

Reichweite und Reichweitenverteilung der Ionen im Festkörper

Da die Stöße zwischen Ionen und Festkörper stochastische Prozesse sind lässt sich nur eine Reichweitenverteilung definieren. Deren Maximum steigt weitgehend linear mit der Ionenenergie, also der Beschleunigungsspannung. Je höher die Dichte der Wirtsmatrix und je höher deren mittlere Kernladungszahl, desto geringer ist die mittlere Reichweite der implantierten Ionen.

Da jeder Stoß auch eine Änderung der Bewegungsrichtung bedingt, ergibt sich für die Verteilung der an einer Stelle implantierten Ionen der in Abb. 124 numerisch modellierte Streukegel. Für den Anwender interessant ist demnach die Reichweitenverteilung der Ionen in die Tiefe des Substrats, also die in Einschussrichtung projizierte Reichweitenverteilung wie sie Abb. 125 für eine laterale Abmessung der implantierten Fläche größer als die Eindringtiefe der Ionen zeigt. Das tiefer unterhalb der Substratoberfläche liegende Ende der Reichweitenverteilung ist durch die Ionen welche bei den Stößen zufällig nahezu keine laterale Auslenkung erfahren haben deutlich schärfer ausgeprägt als der Bereich darüber bis zur Oberfläche des Substrats, wo räumlich stärker gestreute Ionen zur Ruhe kommen, falls sie nicht sogar durch Rückstreuung teilweise auch den Festkörper wieder verlassen haben.

Bei kristallinen Körpern muss zusätzlich die Anisotropie des Streuquerschnitts berücksichtigt werden. In kristallinem Silicium durchziehen in {110}-Richtung sechseckige Kanäle den gesamten Kristall parallel zu denen Ionen wesentlich tiefer in den Festkörper eindringen können als entlang anderer Kristallrichtungen (*Gitterführungseffekt*).

Fotolackprozessierung für die Ionenimplantation

Geeignete Fotolacke

An die als Maske für die Ionenimplantation eingesetzten Fotolacke gibt es neben der Vorgabe für die Lackschichtdicke, die laterale Auflösung und Flankensteilheit üblicherweise keine speziell an die Ionenimplantation ausgerichteten Anforderungen.

Die Erwärmung des Substrats während der Implantation kann es jedoch notwendig machen, einen Fotolack mit einer ausreichend hohen Erweichungstemperatur zu verwenden.

Notwendige Lackschichtdicken

Die Lackmaske muss dick genug sein, um die Ionen an diesen Stellen zuverlässig zu absorbieren. Entsprechend nimmt die notwendige Lackschichtdicke mit der Ionenenergie zu. Je höher die Dichte ρ und mittlere

Kernladungszahl Z der verwendeten Lackmaske, desto dünner kann deren notwendige Schichtdicke zur zuverlässigen Absorption der Ionen ausfallen. Da sich bzgl. dieser Parameter ρ und Z die Matrix wie Phenol-, Epoxie- oder Acryl-Harz gängiger Fotolacke nur in geringem Maß unterscheiden, macht es in der Praxis meist wenig Sinn, die Auswahl des verwendeten Fotolacks speziell an diesem Kriterium auszurichten, sondern an der damit prozessierbaren Lackschichtdicke.

Entfernen der Lackmaske

Der lokal sehr hohe Energieeintrag der Ionen in die Lackmaske führt dort meist zu einer sehr starken Quervernetzung was das nasschemische Entfernen der Lackmaske nach der erfolgten Ionenimplantation erschwert oder unmöglich macht.

Falls nicht einmal Hochleistungs-Remover wie der TechniStrip® P1316 oder NI555 die Lackmaske entfernen können kann es hilfreich sein, die Lackschichtdicke etwas zu erhöhen: Wenn die Ionen bereits ca. 1 μm oberhalb des Substrats von der Lackmaske aufgefangen werden und dort ihre kinetische Energie teilweise in eine Quervernetzung des Harzes umsetzen, bleibt der substratnahe Bereich der Lackmaske unvernetzt so dass sich der Remover entlang dieser Schicht vorarbeiten und den stark quervernetzten Bereich der Lackmaske darüber vom Substrat abheben kann.

Unsere Fotolacke: Anwendungsbereiche und Kompatibilitäten

Anwendungsbereiche ¹		Lackserie	Fotolacke	Schichtdicke ²	Empfohlene Entwickler ³	Empfohlene Remover ⁴
Positiv	Hohe Haftung für nasschemisches Ätzen, kein Fokus auf senkrechte Lackflanken	AZ [®] 1500	AZ [®] 1505 AZ [®] 1512 HS AZ [®] 1514 H AZ [®] 1518	≈ 0,5 µm ≈ 1,0 - 1,5 µm ≈ 1,2 - 2,0 µm ≈ 1,5 - 2,5 µm	AZ [®] 351B, AZ [®] 326 MIF, AZ [®] 726 MIF, AZ [®] Developer	AZ [®] 100 Remover TechniStrip [®] P1316 TechniStrip [®] P1331
		AZ [®] 4500	AZ [®] 4533 AZ [®] 4562	≈ 3 - 5 µm ≈ 5 - 10 µm	AZ [®] 400K, AZ [®] 326 MIF, AZ [®] 726 MIF, AZ [®] 826 MIF	
		AZ [®] P4000	AZ [®] P4110 AZ [®] P4330 AZ [®] P4620 AZ [®] P4903	≈ 1 - 2 µm ≈ 3 - 5 µm ≈ 6 - 20 µm ≈ 10 - 30 µm	AZ [®] 400K, AZ [®] 326 MIF, AZ [®] 726 MIF, AZ [®] 826 MIF	
		AZ [®] PL 177	AZ [®] PL 177	≈ 3 - 8 µm	AZ [®] 351B, AZ [®] 400K, AZ [®] 326 MIF, AZ [®] 726 MIF, AZ [®] 826 MIF	
	Sprühbelackung	AZ [®] 4999		≈ 1 - 15 µm	AZ [®] 400K, AZ [®] 326 MIF, AZ [®] 726 MIF, AZ [®] 826 MIF	
	Tauchbelackung	MC Dip Coating Resist		≈ 2 - 15 µm	AZ [®] 351B, AZ [®] 400K, AZ [®] 326 MIF, AZ [®] 726 MIF, AZ [®] 826 MIF	
	Steile Flanken, hohe Auflösung und großes Aspektverhältnis für z. B. Trockenätzen und Galvanik	AZ [®] ECI 3000	AZ [®] ECI 3007 AZ [®] ECI 3012 AZ [®] ECI 3027	≈ 0,7 µm ≈ 1,0 - 1,5 µm ≈ 2 - 4 µm	AZ [®] 351B, AZ [®] 326 MIF, AZ [®] 726 MIF, AZ [®] Developer	
		AZ [®] 9200	AZ [®] 9245 AZ [®] 9260	≈ 3 - 6 µm ≈ 5 - 20 µm	AZ [®] 400K, AZ [®] 326 MIF, AZ [®] 726 MIF	
Hoher Erweichungspunkt und hochauflösend für z. B. Trockenätzen	AZ [®] 701 MiR	AZ [®] 701 MiR (14 cPs) AZ [®] 701 MiR (29 cPs)	≈ 0,8 µm ≈ 2 - 3 µm	AZ [®] 351B, AZ [®] 326 MIF, AZ [®] 726 MIF, AZ [®] Developer		
Positiv (chem. verstärkt)	Steile Flanken, hohe Auflösung und großes Aspektverhältnis für z. B. Trockenätzen und Galvanik	AZ [®] XT	AZ [®] 12 XT-20PL-05 AZ [®] 12 XT-20PL-10 AZ [®] 12 XT-20PL-20 AZ [®] 40 XT	≈ 3 - 5 µm ≈ 6 - 10 µm ≈ 10 - 30 µm ≈ 15 - 50 µm	AZ [®] 400K, AZ [®] 326 MIF, AZ [®] 726 MIF	AZ [®] 100 Remover TechniStrip [®] P1316 TechniStrip [®] P1331
		AZ [®] IPS 6050		≈ 20 - 100 µm		
Image reversal	Hoher Erweichungspunkt und unterschrittene Lackprofile für Lift-off	AZ [®] 5200	AZ [®] 5209 AZ [®] 5214	≈ 1 µm ≈ 1 - 2 µm	AZ [®] 351B, AZ [®] 326 MIF, AZ [®] 726 MIF	TechniStrip [®] Micro D2 TechniStrip [®] P1316 TechniStrip [®] P1331
		TI	TI 35ESX TI xLift-X	≈ 3 - 4 µm ≈ 4 - 8 µm		
Negativ (quervernetzend)	Unterschnittene Lackprofile und dank Quervernetzung kein thermisches Erweichen für Lift-off	AZ [®] nLOF 2000	AZ [®] nLOF 2020 AZ [®] nLOF 2035 AZ [®] nLOF 2070	≈ 1,5 - 3 µm ≈ 3 - 5 µm ≈ 6 - 15 µm	AZ [®] 326 MIF, AZ [®] 726 MIF, AZ [®] 826 MIF	TechniStrip [®] NI555 TechniStrip [®] NF52 TechniStrip [™] MLO 07
		AZ [®] nLOF 5500	AZ [®] nLOF 5510	≈ 0,7 - 1,5 µm		
	Hohe Haftung, steile Lackflanken und große Aspektverhältnisse für z. B. Trockenätzen und Galvanik	AZ [®] nXT	AZ [®] 15 nXT (115 cPs) AZ [®] 15 nXT (450 cPs)	≈ 2 - 3 µm ≈ 5 - 20 µm	AZ [®] 326 MIF, AZ [®] 726 MIF, AZ [®] 826 MIF	
AZ [®] 125 nXT			≈ 20 - 100 µm	AZ [®] 326 MIF, AZ [®] 726 MIF, AZ [®] 826 MIF		

¹ Theoretisch können alle Lacke für nahezu alle Anwendungen eingesetzt werden. Mit dem Anwendungsbereich sind hier die besonderen Eignungen der jeweiligen Lacke gemeint.
² Mit Standardequipment unter Standardbedingungen erzielbare und prozessierbare Lackschichtdicke. Manche Lacke können für geringere Schichtdicken verdünnt werden, mit entsprechendem Mehraufwand sind auch dickere Lackschichten erziel- und prozessierbar.
³ Metallionenfremde (MIF-) Entwickler sind deutlich teurer und dann sinnvoll, wenn metallionenfremde entwickelt werden muss.

Unsere Entwickler: Anwendungsbereiche und Kompatibilitäten

Anorganische Entwickler

(typischer Bedarf bei Standard-Prozessen: ca. 20 L Entwickler je L Fotolack)

AZ[®] Developer basiert auf Na-Phosphat und Na-Metasilikat, ist auf minimalen Aluminiumabtrag optimiert und wird 1 : 1 verdünnt in DI-Wasser für hohen Kontrast bis unverdünnt für hohe Entwicklungsraten eingesetzt. Der Dunkelabtrag ist verglichen mit anderen Entwicklern etwas höher.

AZ[®] 351B basiert auf gepufferter NaOH und wird üblicherweise 1 : 4 mit Wasser verdünnt angewandt, für Dicklacke auf Kosten des Kontrasts bis ca. 1 : 3

AZ[®] 400K basiert auf gepufferter KOH und wird üblicherweise 1 : 4 mit Wasser verdünnt angewandt, für Dicklacke auf Kosten des Kontrasts bis ca. 1 : 3

AZ[®] 303 speziell für den AZ[®] 111 XFS Fotolack basiert auf KOH / NaOH und wird üblicherweise 1 : 3 - 1 : 7 mit Wasser verdünnt angewandt, je nach Anforderung an Entwicklungsrate und Kontrast.

Metallionenfremde Entwickler (TMAH-basiert)

(typischer Bedarf bei Standard-Prozessen: ca. 5 - 10 L Entwicklerkonzentrat je L Fotolack)

AZ[®] 326 MIF ist eine 2.38 %ige wässrige TMAH- (TetraMethylAmmoniumHydroxid) Lösung.

AZ[®] 726 MIF ist 2.38 % TMAH in Wasser, mit zusätzlichen Netzmitteln zur raschen und homogenen Benetzung des Substrates z. B. für die Puddle-Entwicklung.

AZ® 826 MIF ist 2.38 % TMAH in Wasser, mit zusätzlichen Netzmitteln zur raschen und homogenen Benetzung des Substrates z. B. für die Puddle-Entwicklung und weiteren Additiven zur Entfernung schwer löslicher Lackbestandteile (Rückstände bei bestimmten Lackfamilien), allerdings auf Kosten eines etwas höheren Dunkelabtrags.

Unsere Remover: Anwendungsbereiche und Kompatibilitäten

AZ® 100 Remover ist ein Amin-Lösemittel Gemisch und Standard-Remover für AZ® und TI Fotolacke. Zur Verbesserung seiner Performance kann AZ® 100 Remover auf 60 - 80°C erhitzt werden. Da der AZ® 100 Remover mit Wasser stark alkalisch reagiert eignet er sich für diesbezüglich empfindliche Substratmaterialien wie z. B. Cu, Al oder ITO nur wenn eine Kontamination mit Wasser ausgeschlossen werden kann.

TechniStrip® P1316 ist ein Remover mit sehr starker Lösekraft für Novolak-basierte Lacke (u. a. alle AZ® Positivlacke), Epoxy-basierte Lacke, Polyimide und Trockenfilme. Bei typischen Anwendungstemperaturen um 75°C kann TechniStrip® P1316 auch z. B. durch Trockenätzen oder Ionenimplantation stärker quervernetzte Lacke rückstandsfrei auflösen. TechniStrip® P1316 kann auch im Sprühverfahren eingesetzt werden. Nicht kompatibel mit Au oder GaAs.

TechniStrip® P1331 ist im Falle alkalisch empfindlicher Materialien eine Alternative zum TechniStrip® P1316. Nicht kompatibel mit Au oder GaAs.

TechniStrip® NI555 ist ein Stripper mit sehr starker Lösekraft für Novolak-basierte Negativlacke wie dem AZ® 15 nXT und der AZ® nLOF 2000 Serie und sehr dicke Positivlacken wie dem AZ® 40 XT. TechniStrip® NI555 wurde dafür entwickelt, auch quervernetzte Lacke nicht nur abzulösen, sondern rückstandsfrei aufzulösen. Dadurch werden Verunreinigungen des Beckens und Filter durch Lackpartikel und -häutchen verhindert, wie sie bei Standard-Strippern auftreten können. Nicht kompatibel mit GaAs.

TechniClean™ CA25 ist ein Remover für post etch residue (PER) removal. Äußerst effizient beim selektiven Entfernen organo-metallischer Oxide von Al, Cu, Ti, TiN, W und Ni.

TechniStrip™ NF52 ist ein Sehr effizienter Remover für Negativlacke (Flüssiglacke als auch Trockenfilme). Durch seine Zusammensetzung und speziellen Additive kompatibel mit Metallen üblicherweise eingesetzt für BEOL interconnects oder WLP bumping.

TechniStrip™ Micro D2 ist ein Vielseitig einsetzbarer Stripper für Lift-off Prozesse oder generell dem Auflösen von Positiv- und Negativlacken. Seine Zusammensetzung zielt auf eine verbesserte Kompatibilität zu vielen Metallen sowie III/V Halbleitern.

TechniStrip™ MLO 07 Hoch-effizienter Remover für Positiv- und Negativlacke eingesetzt in den Bereichen IR, III/V, MEMS, Photonic, TSV mask und solder bumping. Kompatibel zu Cu, Al, Sn/Ag, Alumina und einer Vielzahl organischer Substrate.

Unsere Wafer und ihre Spezifikationen

Silicium-, Quarz-, Quarzglas und Glaswafer

Silicium-Wafer werden aus über das Czochralski- (CZ-) oder Floatzone- (FZ-) Verfahren hergestellten Einkristallen gefertigt. Die deutlich teureren FZ-Wafer sind in erster Linie dann sinnvoll, wenn sehr hochohmige Wafer (> 100 Ohm cm) gefordert werden welche über das CZ-Verfahren nicht machbar sind.

Quarzwafer bestehen aus einkristallinem SiO₂, Hauptkriterium ist hier die Kristallorientierung bzgl. der Waferoberfläche (z. B. X-, Y-, Z-, AT- oder ST-Cut)

Quarzglaswafer bestehen aus amorphem SiO₂. Sog. JGS2-Wafer sind im Bereich von ca. 280 - 2000 nm Wellenlänge weitgehend transparent, die teureren JGS1-Wafer bei ca. 220 - 1100 nm.

Unsere Glaswafer bestehen wenn nicht anders angegeben aus im Floatverfahren hergestelltem Borosilikatglas.

Spezifikationen

Für alle Wafer relevant sind Durchmesser, Dicke und Oberfläche (1- oder 2-seitig poliert). Bei Quarzglaswafern ist die Frage nach dem Material (JGS1 oder JGS2) zu klären, bei Quarzwafern die Kristallorientierung. Bei Silicium-Wafern gibt es neben der Kristallorientierung (<100> oder <111>) die Parameter Dotierung (n- oder p-Typ) sowie die elektrische Leitfähigkeit (in Ohm cm)

Prime- Test- und Dummy-Wafer

Bei Silicium-Wafern gibt neben dem üblichen „Prime-grade“ auch „Test-grade“ Wafer, die sich meist nur in einer etwas breiteren Partikelspezifikation von Prime-Wafern unterscheiden. „Dummy-Wafern“ erfüllen aus unterschiedlichen Gründen (z. B. sehr breite oder fehlenden Spezifizierung bestimmter Parameter, evtl. auch Reclaim-Wafer und solche völlig ohne Partikelspezifikation) weder Prime- noch Test-grade, können jedoch für z. B. Belackungstests oder das Einfahren von Equipment eine sehr preiswerte Alternative sein.

Unsere Silicium-, Quarz-, Quarzglas und Glaswafer

Eine ständig aktualisierte Liste der aktuell verfügbaren Wafer finden Sie hier:

☞ www.microchemicals.com/de/produkte/wafer/waferlist.html

Weitere Produkte aus unserem Portfolio

Galvanik

Elektrolyte und Hilfsstoffe für die elektrochemische Abscheidung von z. B. Gold, Kupfer, Nickel, Zinn oder Palladium: ☞ www.microchemicals.com/de/produkte/galvanik.html

Lösemittel (MOS, VLSI, ULSI)

Aceton, Isopropanol, MEK, DMSO, Cyclopentanon, Butylacetat, u. a.

☞ www.microchemicals.com/de/produkte/loesungsmittel.html

Säuren und Basen (MOS, VLSI, ULSI)

Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, KOH, TMAH, u. a.

☞ www.microchemicals.com/de/produkte/saeuren_basen.html

Ätzmischungen

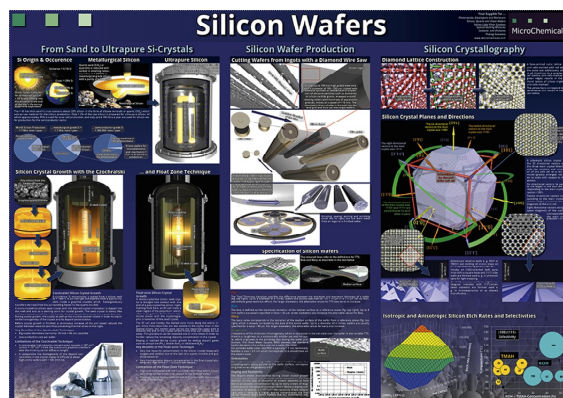
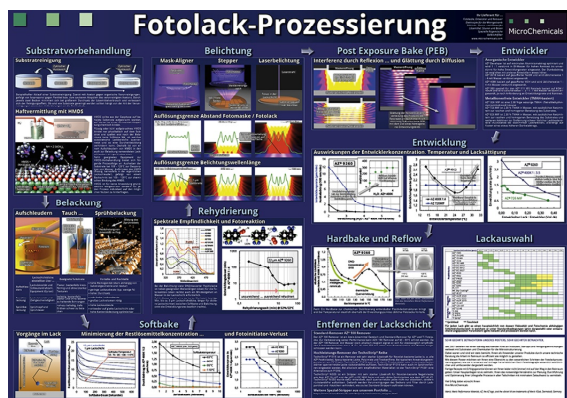
Für z. B. Chrom, Gold, Silicium, Kupfer, Titan, Titan / Wolfram u. a.

☞ www.microchemicals.com/de/produkte/aetzmischungen.html

Weiterführende Informationen

Technische Datenblätter: www.microchemicals.com/de/downloads/technische_datenblaetter/fotolacke.html
Sicherheitsdatenblätter: www.microchemicals.com/de/downloads/sicherheitsdatenblaetter/sicherheitsdatenblaetter.html

Unsere Lithografiebücher und -Poster



Wir sehen es als unsere Aufgabe, Ihnen möglichst alle Aspekte der Mikrostrukturierung anwendungsorientiert verständlich zu machen.

Diesen Anspruch umgesetzt haben wir derzeit mit unserem Buch **Fotolithografie** auf über 200 Seiten, sowie ansprechend gestalteten DIN A0 **Postern** für Ihr Büro oder Labor.

Beides senden wir Ihnen als unser Kunde gerne gratis zu (ggf. berechnen wir für außereuropäische Lieferungen Versandkosten):

www.microchemicals.com/de/downloads/broschueren.html

www.microchemicals.com/de/downloads/poster.html

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Gewährleistungs- und Haftungsausschluss & Markenrechte

Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Prozessbeschreibungen, Rezepturen etc. sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dennoch können wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben übernehmen. Insbesondere bezüglich der Rezepturen für chemische (Ätz-)Prozesse übernehmen wir keine Gewährleistung für die korrekte Angabe der Bestandteile, der Mischverhältnisse, der Herstellung der Ansätze und deren Anwendung. Die sichere Reihenfolge des Mischens von Bestandteilen einer Rezeptur entspricht üblicherweise nicht der Reihenfolge ihrer Auflistung.

Wir garantieren nicht für die vollständige Angabe von Hinweisen auf (u. a. gesundheitliche, arbeitssicherheitstechnische) Gefahren, die sich bei Herstellung und Anwendung der Rezepturen und Prozesse ergeben. Die Angaben in diesem Buch basieren im Übrigen auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Grundsätzlich ist jeder Mitarbeiter dazu angehalten, sich im Zweifelsfall in geeigneter Fachliteratur über die angedachten Prozesse vorab ausreichend zu informieren, um Schäden an Personen und Equipment auszuschließen. Alle hier vorliegenden Beschreibungen, Darstellungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte, etc. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht eine vertraglich vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Rechtsvorschriften sind vom Verwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Merck, Merck Performance Materials, AZ, the AZ logo, and the vibrant M are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

MicroChemicals GmbH
Nicolaius-Otto-Str. 39
89079, Ulm
Germany

Fon: +49 (0)731 977 343 0
Fax: +49 (0)731 977 343 29
e-Mail: info@microchemicals.net
Internet: www.microchemicals.net